



平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年7月30日

上場会社名 東京エレクトロン株式会社
 コード番号 8035 URL <http://www.tel.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 竹中 博司
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役 執行役員 (氏名) 原田 芳輝
 四半期報告書提出予定日 平成24年8月7日
 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

上場取引所 東

TEL 03-5561-7000

(百万円未満切捨て)

1. 平成25年3月期第1四半期の連結業績(平成24年4月1日～平成24年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
25年3月期第1四半期	134,179	△12.4	9,283	△59.8	11,248	△52.6	5,720	△65.6
24年3月期第1四半期	153,117	5.7	23,088	26.0	23,751	24.6	16,636	13.0

(注) 包括利益 25年3月期第1四半期 2,649百万円 (△84.2%) 24年3月期第1四半期 16,772百万円 (68.1%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
25年3月期第1四半期	31.93	31.88
24年3月期第1四半期	92.91	92.76

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	
	百万円	%	百万円	%		
25年3月期第1四半期	767,049		596,323		76.2	
24年3月期	783,610		598,602		74.9	

(参考) 自己資本 25年3月期第1四半期 584,567百万円 24年3月期 586,789百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
24年3月期	—	53.00	—	27.00	80.00
25年3月期	—	—	—	—	—
25年3月期(予想)	—	25.00	—	26.00	51.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

平成25年3月期の第2四半期末配当金の内訳は、普通配当15円、記念配当10円です。
 平成25年3月期の期末配当金の内訳は、普通配当16円、記念配当10円です。

3. 平成25年3月期の連結業績予想(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	268,000	△17.9	9,500	△74.2	6,000	△77.5	33.49
通期	530,000	△16.3	20,000	△66.9	14,000	△61.9	78.14

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

詳細は、【添付資料】6ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 有
- ④ 修正再表示 : 無

第1四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細は、【添付資料】6ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	25年3月期1Q	180,610,911 株	24年3月期	180,610,911 株
② 期末自己株式数	25年3月期1Q	1,437,590 株	24年3月期	1,446,079 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	25年3月期1Q	179,169,890 株	24年3月期1Q	179,065,796 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】5ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

・当社は、平成24年7月30日に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料につきましては、開催と同時に当社ホームページに掲載する予定です。

【添付資料】

[目次]

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	4
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	5
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	6
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	6
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	6
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	6
3. 四半期連結財務諸表	7
(1) 四半期連結貸借対照表	7
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	8
(3) 継続企業の前提に関する注記	10
(4) セグメント情報等	10
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期連結累計期間の世界経済は、欧州の財政不安が未だ解消せず、中国の経済成長率にも先行き不透明感が出てくるなど、全体的に減速傾向が見られました。日本経済においては、世界経済の停滞感を受け回復の進展は緩やかとなっております。

当社グループの参画しておりますエレクトロニクス産業に関しましては、スマートフォンは引き続き堅調であるものの、パソコンやテレビなどの販売が依然として低迷していることから、半導体や液晶パネルの市況全般の回復には結びついておりません。

このような状況のもと、当第1四半期連結累計期間の連結業績は、売上高1,341億7千9百万円(前年同期比12.4%減)、営業利益92億8千3百万円(前年同期比59.8%減)、経常利益112億4千8百万円(前年同期比52.6%減)、また、四半期純利益は57億2千万円(前年同期比65.6%減)となりました。

セグメント別の概況は以下のとおりです。

① 半導体製造装置

スマートフォン需要で半導体市場全体を牽引するまでには至らず、半導体価格は軟調に推移しました。これを受け、半導体メーカーにおいては一部先端開発分野への設備投資は行ったものの、メモリー向けの設備投資は手控えられ、全体として大規模な投資には結びつきませんでした。このような状況のもと、当セグメントの当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、1,087億3百万円(前年同期比10.0%減)となりました。

② FPD/PV (フラットパネルディスプレイ及び太陽光パネル) 製造装置

テレビやパソコンの需要回復には至っておらず、液晶パネル用製造装置の需要は低調でした。このような状況のもと、当セグメントの当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、47億6千9百万円(前年同期比62.0%減)となりました。

③ 電子部品・情報通信機器

当社連結子会社において(株)アムスクからの事業譲り受けにより汎用ICの売上は増加しましたが、景況感の悪化による需要減速から、これ以外の電子部品、情報通信機器の販売は低調に推移しました。このような状況のもと、当セグメントの当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、206億5百万円(前年同期比4.9%増)となりました。

④ その他

当セグメントの当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、1億1百万円(前年同期比5.2%増)となりました。

(ご参考)

【連結業績】

(単位：百万円)

	前期通期					当期第1Q
	前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q		
売上高	633,091	153,117	173,232	129,164	177,576	134,179
半導体製造装置	477,873	120,836	127,557	91,596	137,882	108,703
日本	82,887	20,943	29,421	16,641	15,881	10,032
米国	114,821	29,756	23,823	28,641	32,601	26,629
欧州	49,325	13,999	16,988	9,545	8,792	10,457
韓国	108,740	16,926	20,957	20,647	50,209	24,214
台湾	75,018	24,705	19,458	9,687	21,166	29,338
中国	25,395	9,115	6,685	3,931	5,663	5,666
東南アジア他	21,683	5,390	10,222	2,501	3,568	2,363
F P D / P V 製造装置	69,888	12,536	24,141	16,633	16,577	4,769
電子部品・情報通信機器	84,867	19,648	21,388	20,865	22,964	20,605
その他	461	96	145	68	151	101
営業利益	60,443	23,088	13,770	6,094	17,489	9,283
経常利益	64,046	23,751	15,970	6,998	17,326	11,248
四半期(当期)純利益	36,725	16,636	10,021	755	9,312	5,720

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

【生産及び受注の実績】

1. 生産実績

(単位：百万円)

	前期通期					当期第1Q
	前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q		
半導体製造装置	452,364	127,147	105,286	97,098	122,832	96,681
F P D / P V 製造装置	55,855	14,115	15,841	16,035	9,863	2,121
合 計	508,220	141,262	121,127	113,134	132,695	98,803

(注) 1. 金額は販売価格によっております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 受注実績 (受注高)

(単位：百万円)

	前期通期					当期第1Q
	前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q		
半導体製造装置	437,615	112,692	73,531	144,971	106,419	76,029
F P D / P V 製造装置	18,598	8,920	1,713	5,078	2,885	2,829
電子部品・情報通信機器	84,276	22,508	19,584	20,441	21,741	22,631
その他	461	96	145	68	151	101
合 計	540,950	144,217	94,974	170,560	131,197	101,590

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. 受注実績 (受注残高)

(単位：百万円)

	前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q	当期第1Q
半導体製造装置	220,798	166,773	220,148	188,684	157,737
F P D / P V 製造装置	61,875	39,447	27,892	14,200	12,260
電子部品・情報通信機器	17,235	15,430	15,006	13,783	15,809
その他	—	—	—	—	—
合 計	299,909	221,651	263,048	216,669	185,807

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

① 財政状態

当第1四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ374億8千6百万円減少の5,695億6千3百万円となりました。主な内容は、受取手形及び売掛金の減少267億1千万円、未収消費税等の減少136億6百万円、有価証券に含まれる短期投資の減少131億5千3百万円、現金及び預金の増加182億2千万円によるものであります。

有形固定資産は、前連結会計年度末から24億4千5百万円増加し、1,293億3千万円となりました。

無形固定資産は、のれんの増加155億4千3百万円などにより、前連結会計年度末から154億6千6百万円増加し、201億6千9百万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末から30億1千3百万円増加し、479億8千4百万円となりました。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末から165億6千1百万円減少の7,670億4千9百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ143億2千7百万円減少の1,104億6千7百万円となりました。主として、支払手形及び買掛金の減少113億6千1百万円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ4千5百万円増加の602億5千8百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ22億7千9百万円減少の5,963億2千3百万円となりました。主として、四半期純利益57億2千万円を計上したことによる増加、前期の期末配当48億3千7百万円の実施による減少、円高の影響による為替換算調整勘定の減少21億8千万円によるものであります。この結果、自己資本比率は76.2%となりました。

② キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の当第1四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ159億2千6百万円減少し、1,428億4千9百万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資1,098億4千2百万円を加えた残高は、前連結会計年度末に比べ50億6千7百万円増加し、2,526億9千2百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

営業活動により獲得したキャッシュ・フローにつきましては、前年同期に比べ178億2千6百万円増加の358億6千4百万円となりました。主な要因につきましては、税金等調整前四半期純利益112億3千1百万円、売上債権の減少260億1千万円、未収消費税等の減少135億4千1百万円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、仕入債務の減少114億2千5百万円がキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。

投資活動により支出したキャッシュ・フローにつきましては、主として連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出158億3千万円、有形固定資産の取得による支出73億2千6百万円、定期預金及び短期投資の増加額210億円により、前年同期の587億4千8百万円に対し460億6千5百万円となりました。

財務活動により支出したキャッシュ・フローにつきましては、主に配当金の支払48億3千7百万円により、前年同期の142億9百万円に対し48億8千9百万円となりました。

【連結キャッシュ・フロー(要約)】

(単位：百万円)

	前第1四半期 連結累計期間	当第1四半期 連結累計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,038	35,864
税金等調整前四半期純利益	23,423	11,231
減価償却費	4,744	5,585
売上債権の増減額(△は増加)	11,412	26,010
たな卸資産の増減額(△は増加)	△15,650	5,112
仕入債務の増減額(△は減少)	686	△11,425
その他	△6,578	△650
投資活動によるキャッシュ・フロー	△58,748	△46,065
定期預金及び短期投資の増減額(△は増加)	△54,000	△21,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	—	△15,830
その他(固定資産の取得等)	△4,748	△9,234
財務活動によるキャッシュ・フロー	△14,209	△4,889
現金及び現金同等物に係る換算差額	53	△835
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△54,865	△15,926
現金及び現金同等物の期首残高	165,050	158,776
現金及び現金同等物の四半期末残高	110,184	142,849
現金及び現金同等物並びに満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資の四半期末残高	284,184	252,692

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

世界的な景気減速を背景に半導体需要は伸び悩んでおり、デバイスメーカー各社は設備投資を控える傾向にあります。このような状況のもと、主力の半導体製造装置部門の売上が期初予想を下回る見通しとなったため、平成24年4月27日に公表した第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想を修正いたします。

平成25年3月期の連結業績予想

	第2四半期連結累計期間	通 期
売上高	2,680億円 (前年同期比17.9%減)	5,300億円 (前年同期比16.3%減)
半導体製造装置	2,160億円 (前年同期比13.0%減)	4,160億円 (前年同期比12.9%減)
F P D / P V 製造装置	90億円 (前年同期比75.5%減)	180億円 (前年同期比74.2%減)
電子部品・情報通信機器	430億円 (前年同期比4.8%増)	960億円 (前年同期比13.1%増)
営業利益	95億円 (前年同期比74.2%減)	200億円 (前年同期比66.9%減)
当期(四半期)純利益	60億円 (前年同期比77.5%減)	140億円 (前年同期比61.9%減)

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

※この決算短信に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社グループが合理的であると判断した一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否、並びに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の計算

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第1四半期連結会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。

3. 四半期連結財務諸表
(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成24年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	35,834	54,055
受取手形及び売掛金	150,305	123,595
有価証券	211,790	198,636
商品及び製品	101,789	100,287
仕掛品	35,104	31,329
原材料及び貯蔵品	12,575	12,506
その他	61,026	50,272
貸倒引当金	△1,376	△1,119
流動資産合計	607,050	569,563
固定資産		
有形固定資産	126,885	129,330
無形固定資産		
のれん	—	15,543
その他	4,703	4,626
無形固定資産合計	4,703	20,169
投資その他の資産		
その他	48,819	51,678
貸倒引当金	△3,848	△3,693
投資その他の資産合計	44,971	47,984
固定資産合計	176,560	197,485
資産合計	783,610	767,049
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	46,986	35,625
未払法人税等	4,288	8,468
製品保証引当金	8,903	8,594
その他の引当金	9,077	3,260
その他	55,537	54,518
流動負債合計	124,794	110,467
固定負債		
退職給付引当金	54,646	54,862
その他の引当金	619	568
その他	4,947	4,827
固定負債合計	60,213	60,258
負債合計	185,007	170,725
純資産の部		
株主資本		
資本金	54,961	54,961
資本剰余金	78,023	78,023
利益剰余金	471,186	472,063
自己株式	△9,747	△9,689
株主資本合計	594,422	595,358
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	3,575	2,575
繰延ヘッジ損益	△51	△27
為替換算調整勘定	△11,157	△13,338
その他の包括利益累計額合計	△7,633	△10,790
新株予約権	1,156	1,167
少数株主持分	10,656	10,588
純資産合計	598,602	596,323
負債純資産合計	783,610	767,049

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年6月30日)
売上高	153,117	134,179
売上原価	94,646	90,067
売上総利益	58,470	44,111
販売費及び一般管理費		
研究開発費	18,176	17,928
その他	17,204	16,899
販売費及び一般管理費合計	35,381	34,827
営業利益	23,088	9,283
営業外収益		
為替差益	—	513
その他	842	1,516
営業外収益合計	842	2,029
営業外費用		
閉鎖拠点維持管理費用	44	17
支払補償費	—	14
為替差損	63	—
その他	71	32
営業外費用合計	179	64
経常利益	23,751	11,248
特別利益		
固定資産売却益	3	1
償却債権取立益	1,437	—
その他	38	—
特別利益合計	1,478	1
特別損失		
固定資産除売却損	4	17
災害による損失	980	—
投資有価証券評価損	800	—
その他	22	—
特別損失合計	1,806	17
税金等調整前四半期純利益	23,423	11,231
法人税等	6,592	3,255
過年度法人税等	—	2,194
少数株主損益調整前四半期純利益	16,831	5,782
少数株主利益	195	62
四半期純利益	16,636	5,720

四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	16,831	5,782
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	334	△1,000
繰延ヘッジ損益	44	70
為替換算調整勘定	△437	△2,202
その他の包括利益合計	△58	△3,132
四半期包括利益	16,772	2,649
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	16,566	2,563
少数株主に係る四半期包括利益	205	86

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) セグメント情報等

① 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、BU(ビジネスユニット)を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「半導体製造装置」、「FPD/PV(フラットパネルディスプレイ及び太陽光パネル)製造装置」及び「電子部品・情報通信機器」を報告セグメントとしております。

「半導体製造装置」の製品は、ウェーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、プラズマエッチング装置、熱処理成膜装置、枚葉成膜装置、洗浄装置、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプローバ及びその他半導体製造装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「FPD/PV製造装置」の製品は、フラットパネルディスプレイ製造用のコータ/デベロッパ、プラズマエッチング/アッシング装置及び薄膜シリコン太陽光パネル製造用のプラズマCVD装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「電子部品・情報通信機器」は、集積回路(IC)を中心とした半導体製品、その他電子部品、コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェア等の設計・開発・仕入・販売等を行っております。

② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第1四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年6月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 3
	半導体 製造装置	FPD/PV 製造装置	電子部品・ 情報通信機器				
売上高	108,703	4,769	20,828	3,077	137,378	△3,198	134,179
セグメント利益 又は損失(△)	16,798	△1,685	201	496	15,811	△4,579	11,231

- (注) 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループの物流、施設管理及び保険業務等を含んでおります。
2. セグメント利益又は損失の調整額△4,579百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社における基礎研究又は要素研究等の研究開発費△4,683百万円であります。
3. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。

③ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

当第1四半期連結会計期間において、米国法人NEXX Systems, Inc.の全株式を取得し、連結子会社としました。当該事象により「半導体製造装置」セグメントにおいて、のれんが15,310百万円発生しております。なお、のれんの金額は取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定された金額であります。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。